

申込み先:軟包装衛生協議会事務局 行き (FAX)03-3548-2939

2016年度 軟衛協・技術セミナー(東京地区)

軟包装衛生協議会では、衛生管理、品質管理、技術開発などの内容を盛り込んだ「軟衛協・技術セミナー」を東京で開催いたします。

このセミナーは、自由参加となります。どなたでも参加いただけます。

今回の内容は、下記の通りです。お申込みをお待ちしております。

受付開始

日時	2016年7月22日(金) 13:00~17:00
会場	コンベンションルーム AP東京 八重洲通り 東京都中央区京橋1丁目10-7 KPP八重洲ビル 電話:03-6228-8109
講演内容	1.「多品種小ロット・レトルトパウチ製品への 新規印刷システム『パウチポスト印刷システム』」 東洋製罐株式会社 テクニカル本部 メタル技術部 加飾技術グループ 深堀 厚 氏
	2.「PTPに代わる次世代錠剤用包装『ESOP』について」 株式会社モリモト医薬 代表取締役 盛本 修司 氏
	3.「燃烧時にCO₂を削減する新技術『エコナノ』の包材への展開について」 サトーグリーンエンジニアリング株式会社 担当部長 山室 博巳 氏
	4.「酸素バリア接着剤『PASLIM』により環境調和を提案」 DIC株式会社 東京工場 接着剤技術本部 接着剤技術1グループ 主任研究員 下口 睦弘 氏
参加費	3,000円(消費税込み)/1名(当日会場にて)
人数	100名 先着受付順しめ切り(FAX、メールのどちらかでお申込みください)
事務局	電話:03-3548-4111 FAX:03-3548-2939 E-mail:jimukyoku@naneikyo.com URL:http://www.naneikyo.com

軟衛協・技術セミナー申込書 (FAX)03-3548-2939

No. ●

会社名			
所在地	〒		
電話	()	FAX	()
参加希望者	(氏名) フリガナ	(所属・役職)	

※ この申込書には入力出来ます。入力後に出力をして、FAXでお送りください